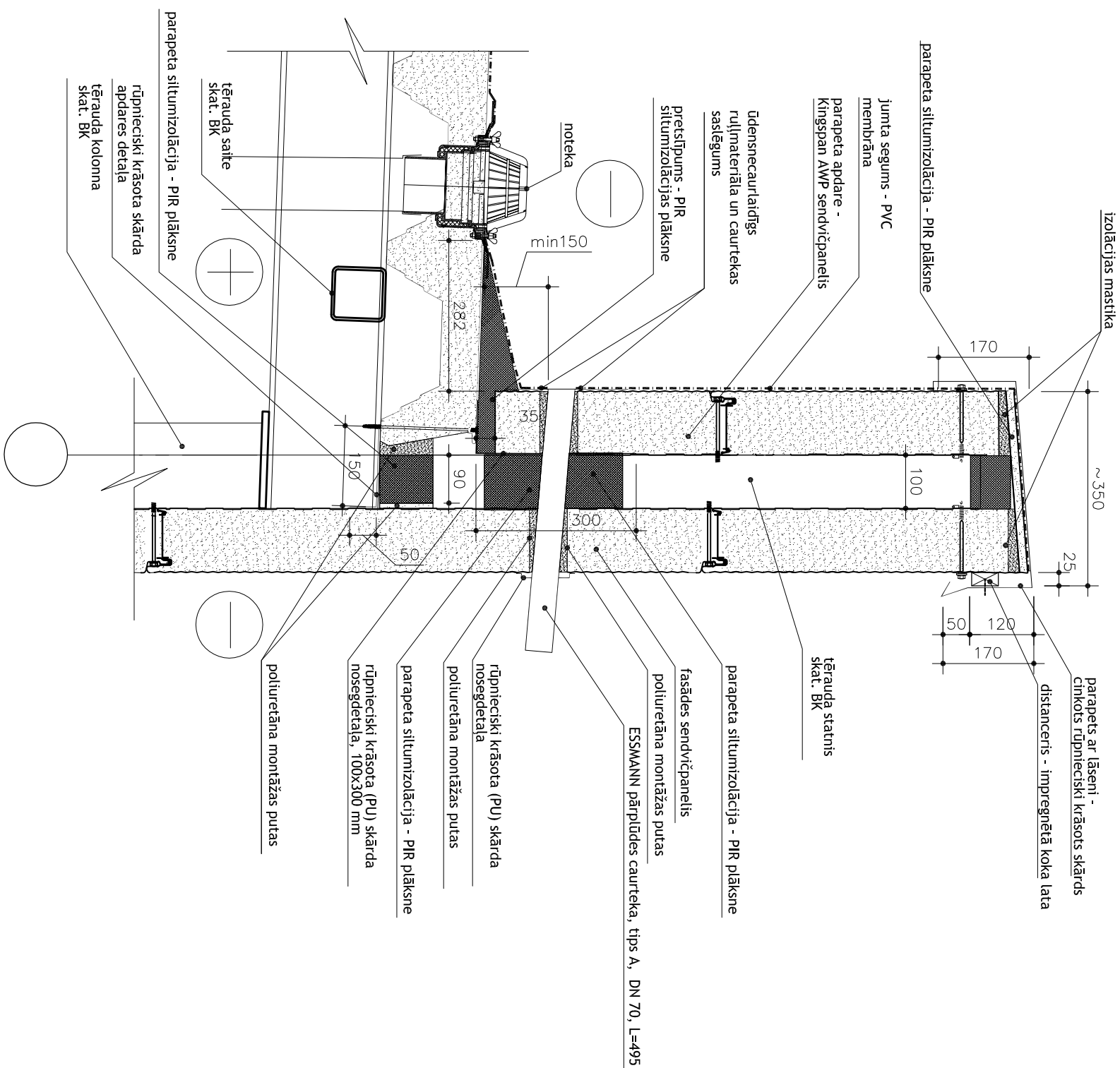



mezgls c



## PIEZĪMES

1. Vīsi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Fasādes apdare - horizontāli montēts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar slēptu horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, paneļu saslēguma vertikālā šuve nosegta ar detaļu K185 (KINGSPAN sortiments)
3. Parapeta apdare - horizontāli montēts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar slēptu horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, paneļu saslēguma vertikālā šuve nosegta ar detaļu K175a (KINGSPAN sortiments).
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārklāšanos un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
5. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
6. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parapeta virspusē.
7. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērīt rasējumu aizliegts.
8. Pārplūdes caurteku izvietojumu skatīt jumta plānā AR-103.

Atbildīgais projektētājs				ARHITEKTU BĪROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIČU 4-136, LV-1006
BPV	RALFS ROZENVALDS			
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS			
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA			
Arhitekts	NATAĻJA KUZŅECOVA			
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE			
Pasūtītājs	Ventspils Brīvostas pārvalde	Pasūt. Nr.	VP-EC-12	
Objekts	Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī	Stadija	TP	
		Lapa	ARD-201	
		Mērogs	1:10	
Faiss	Mezgli_1estrades-2014_01_23.dwg	Arh. reg. Nr.		
Rasējums	Parapets - sendvičpaneļu siena, mezgls c	Datums	27.01.2014.	